

川崎机器人邀您共赴

SEMI-e 第六届深圳半导体技术暨应用展览会

随着人工智能、5G、物联网、智能汽车等新兴技术的发展，半导体行业迎来巨大的发展机遇。备受期待的**第六届深圳半导体技术暨应用展览会**（以下简称“SEMI-e”）即将于6月26日至28日亮相深圳国际会展中心4/6/8号馆。



川崎机器人通过提供高性能的自动化解决方案，帮助制造商应对生产成本的降低、技术进步和市场扩张带来的机遇，同时也应对科技消费领域快速变化带来的挑战。

本次展会，川崎将携**真空晶圆搬运机器人 NV117S**、**晶圆搬运机器人 NTH20+校准器 Buffer aligner** 参展，推动半导体行业的智能化浪潮发展。晶圆搬运是半导体制造装置的前工序中的一道重要工序，尤其需要高精度和高速度。川崎的晶圆搬运机器人可以提供高品质、高性能的洁净机器人，市场占有率在全球名列前茅。

展会时间：2024年6月26日-6月28日

展会地点：深圳国际会展中心 4/6/8 号馆

川崎展位：展位号：8D32



展品介绍

真空晶圆搬运机器人 NV117S

1. 紧凑型机械臂节省空间

2. 适应高真空环境
3. 精密度极高，运作流畅

晶圆搬运机器人 NTH20+校准器 BUFFER ALIGNER

1. 最新 BUFFER 型校准仪和 4LP 夹持器，实现单臂双校准仪同步校准，提升效率
2. 校准器双 BUFFER Aligner 显著缩短校准时长，实现双叉同步放取片
3. 在 4LP sorter 布局下，产能可达 400wph 以上

深圳国际会展中心 8D32 展位

川崎机器人期待与您相见

共同助力中国半导体市场加速发展

立即扫码 预约参展



川崎机器人（天津）有限公司